

JS-T100-THK-II 高精度厚膜レーザートリマー



高精度厚膜チップ抵抗器の抵抗値トリミングをより高速、
高精度に最適なソリューションを提供します

HIPA 高精度厚膜レーザートリマーの特徴

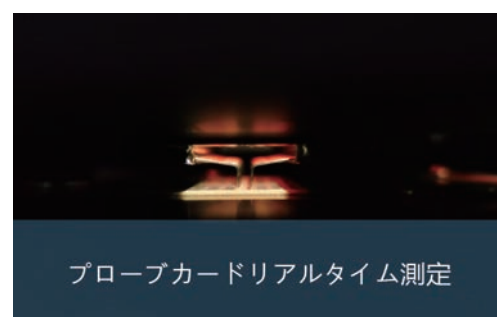
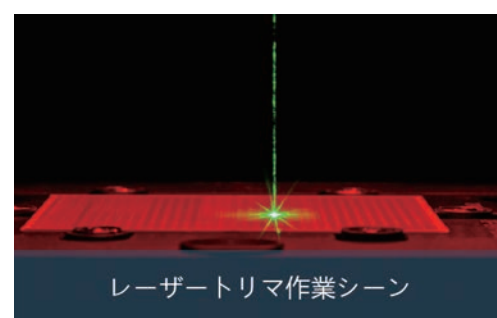
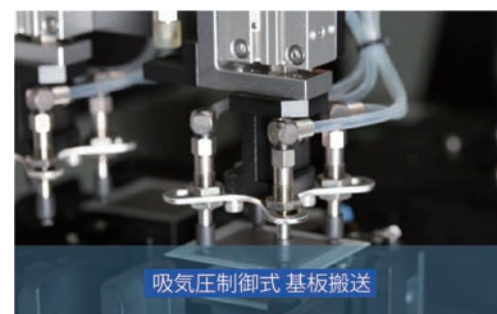
HIPA 薄膜用レーザートリマーは、波長 355nm の UV レーザーを標準搭載、秀逸な光学系により絞られたレーザー光は瞬時に厚膜抵抗体をガス化し、クリアなトリミング跡を形成します。より細くてシャープなレーザー切削により、厚膜抵抗に与えるダメージを限りなく小さくし高精度なトリミングが可能です。

HIPA 高精度厚膜用トリマーは、レーザーユニット・測定ユニット・制御ユニットの各ユニットの優れた機能を最大限に引き出す組み合わせにより構成されています。

- * 独自の自社開発測定システム及び制御システムを搭載
高精度な測定と制御を可能にしています。
- * UV レーザーユニットの搭載により、厚膜抵抗体への熱影響を小さくします。
それにより高精度なトリミングが可能となります。
- * 自社開発のトリミングソフトを使用。自由度の高いトリミングプログラムが可能です。（L 字カット、ダブルカット、IL カットなど）
- * テーブル搬送繰り返し精度 1 μ m、クランプ繰り返し精度 10 μ m

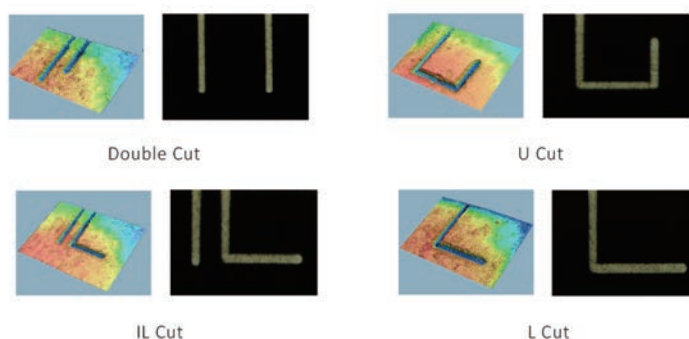
仕様

型番	JS-T100-THK-II
適応素子サイズ	1005mm以上 (0402inch以上)
抵抗値設定範囲	0.1 Ω - 10 MΩ
抵抗値精度	0.1% 以上(※1)
レーザー溝幅	10 - 12 μm
レーザー出力	UV 5 W (1-10W 選択可能)
ビームエキスパンダ	2 - 10 倍
フォーカス距離	103 mm
ガルバノメーター位置精度	± 1 μm
テーブル搬送位置精度	1 μm
テーブルランプ繰返し精度	10 μm以内
測定チャンネル	192 / 240
プローブカード固定	水平調節可能



※1 トリミング精度は対象製品とトリミング方法（カット方法及びカット速度）によりかわります。 目的とする精度に合わせて調整が可能です。

カット例



0.1%精度 厚膜抵抗器

高エネルギーレーザーは、界面の熱影響と温度特性により精度を劣化させます。本装置はUV固体レーザーを用い、極めて局所的なレーザー照射により、熱影響を大幅に減らします。高精度測定システムと合わせて厚膜抵抗器の性能を向上させます。

システム



仕様は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。